

**Hirata**

平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2025年5月

# 決算説明資料

2024年度(2025年3月期)

# 目次

- I. 2024年度 通期業績（連結）
- II. 2025年度 通期業績予想（連結）
- III. 株主還元等について
- IV. 参考資料

## 会社概要

会社名	平田機工株式会社 (英文表記:HIRATA Corporation)
所在地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長執行役員 平田 雄一郎
設立	1951年12月29日
資本金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード 6258)
従業員	連結 2,347名 単体 1,502名 ※2025年3月31日現在
事業所	国内7拠点(熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都)
関係会社	国内3社 (熊本県2社、東京都) 海外9社 (アメリカ、メキシコ、シンガポール、タイ、マレーシア、中国2社、台湾、ドイツ※)

※ ドイツの関係会社は5月1日より清算手続きを開始

# I . 2024年度 通期業績（連結）

## 業績概要

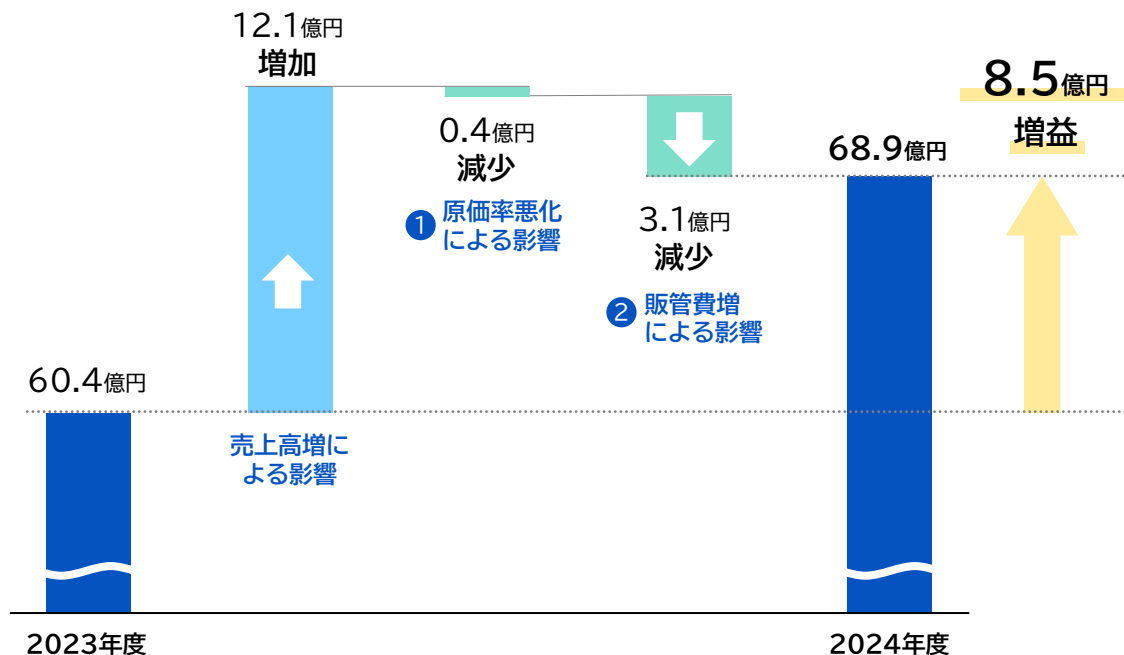
- **受注高** 対前期で減。半導体関連は2Q以降好調を維持するも、自動車関連の受注が顧客の開発遅延等により減少
- **売上高** 対前期で増。自動車関連を中心に受注済案件の生産が進捗
- **営業利益** 対前期で増。増収により増益。半導体関連は営業利益率が低下したものの、自動車関連では改善

(単位：百万円)

	2023年度	2024年度	対前期	
	実績	実績	増減額	増減率
受注高	86,239	79,512	▲6,726	▲7.8%
売上高	82,839	88,483	5,644	6.8%
営業利益 (利益率)	6,047 (7.3%)	6,898 (7.8%)	850	14.1%
経常利益	6,259	6,889	629	10.1%
親会社株主に 帰属する当期純利益	4,344	4,778	433	10.0%
受注残高	65,404	56,433	▲8,971	▲13.7%

# 営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前期で8.5億円増
  - 主な増加要因：売上高の増加
  - 主な減少要因：販管費の増加



## ① 原価率悪化による影響

原価率 78.5% ⇒ 78.6%

原価率の主な悪化要因

- ・ 賃上げ・人員増による人件費増
- ・ 減価償却費増
- ・ 物価上昇による影響

原価率の主な改善要因

- ・ 価格転嫁の推進
- ・ 習熟度向上による収益性の改善

## ② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- ・ 賃上げ・人員増による人件費増 等

## セグメント別業績まとめ

(単位：百万円)		2023年度	2024年度	増減額	増減率
受注高	合計	86,239	79,512	▲6,726	▲7.8%
	自動車	44,492	34,111	▲10,381	▲23.3%
	半導体	25,107	29,730	4,622	18.4%
	その他自動省力機器	14,357	13,351	▲1,006	▲7.0%
	その他	2,281	2,319	37	1.7%
売上高	合計	82,839	88,483	5,644	6.8%
	自動車	36,984	43,059	6,074	16.4%
	半導体	27,390	30,186	2,796	10.2%
	その他自動省力機器	16,083	13,096	▲2,986	▲18.6%
	その他	2,381	2,141	▲239	▲10.1%
営業利益	合計	6,047	6,898	850	14.1%
	自動車	1,651	4,194	2,543	154.0%
	半導体	4,450	2,857	▲1,592	▲35.8%
	その他自動省力機器	119	▲101	▲221	-
	その他（消去含む）	▲173	▲52	120	-
受注残高	合計	65,404	56,433	▲8,971	▲13.7%
	自動車	39,150	30,202	▲8,947	▲22.9%
	半導体	19,470	19,013	▲456	▲2.3%
	その他自動省力機器	6,295	6,549	254	4.0%
	その他	488	667	178	36.5%

## セグメント別業績：自動車関連

- **受注高** 対前期で減。いくつかの大型案件（EV・内燃機関）の受注時期が顧客の開発遅延等により翌期に延期
- **売上高** 対前期で増。EV関連案件（主にEDUやバッテリー関連）および内燃機関案件の生産が進捗。拡大した生産スペースも生産増に寄与
- **営業利益** 対前期で増。高い増収効果に加え、個別案件における価格転嫁の推進や習熟度の向上により収益性が改善し増益

(単位：百万円)

	2023年度		2024年度		対前期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	44,492	-	34,111	-	▲10,381	▲23.3%
EV	25,112	56.4%	24,336	71.3%	▲775	▲3.1%
その他	19,380	43.6%	9,774	28.7%	▲9,605	▲49.6%
売上高	36,984	-	43,059	-	6,074	16.4%
EV	27,627	74.7%	28,220	65.5%	593	2.1%
その他	9,357	25.3%	14,838	34.5%	5,481	58.6%
受注残高	39,150	-	30,202	-	▲8,947	▲22.9%
営業利益	1,651	-	4,194	-	2,543	154.0%
営業利益率	4.5%	-	9.7%	-	-	-



## セグメント別業績：半導体関連

- **受注高** 対前期で増。生成AI関連の需要拡大を受け、2Q以降は好調を維持
- **売上高** 対前期で増。受注の増加を受け、特にウェーハ搬送関連設備の生産が進捗
- **営業利益** 対前期で減。高利益率案件が減少したことに加え、部材価格の高騰および価格転嫁の遅れにより原価率が悪化。また、一部製品に対し保証費用を引き当てたことも影響

(単位：百万円)

	2023年度		2024年度		対前期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
<b>受注高</b>	<b>25,107</b>	-	<b>29,730</b>	-	4,622	18.4%
ウェーハ搬送	16,646	66.3%	21,178	71.2%	4,532	27.2%
その他	8,460	33.7%	8,551	28.8%	90	1.1%
<b>売上高</b>	<b>27,390</b>	-	<b>30,186</b>	-	2,796	10.2%
ウェーハ搬送	18,836	68.8%	21,258	70.4%	2,422	12.9%
その他	8,553	31.2%	8,927	29.6%	374	4.4%
<b>受注残高</b>	<b>19,470</b>	-	<b>19,013</b>	-	▲456	▲2.3%
<b>営業利益</b>	<b>4,450</b>	-	<b>2,857</b>	-	▲1,592	▲35.8%
<b>営業利益率</b>	<b>16.2%</b>	-	<b>9.5%</b>	-	-	-

## セグメント別業績：その他自動省力機器

- **受注高** 対前期で減。家電関連やタイヤ等の物流関連の設備投資が減少し前期を下回る
- **売上高** 対前期で減。FPD関連や物流関連が前期から減少
- **営業利益** 対前期で減。受注・売上の減少を受け原価・販管費の抑制を図るも、一部案件における原価率悪化により減益

(単位：百万円)

	2023年度		2024年度		対前期	
	実績	セグメント内構成比	実績	セグメント内構成比	増減額	増減率
受注高	14,357	-	13,351	-	▲1,006	▲7.0%
売上高	16,083	-	13,096	-	▲2,986	▲18.6%
受注残高	6,295	-	6,549	-	254	4.0%
営業利益	119	-	▲101	-	▲221	-
営業利益率	0.7%	-	▲0.8%	-	-	-

## 貸借対照表

（単位：百万円）

資産	2023年度	2024年度	増減
<b>流動資産</b>	88,554	<b>88,035</b>	<b>▲518</b>
現金及び預金	10,652	12,882	2,229
売上債権	59,504	56,561	▲2,942
棚卸資産	14,264	15,510	1,245
その他	4,131	3,080	▲1,050
<b>固定資産</b>	42,233	<b>42,243</b>	<b>9</b>
有形固定資産	27,437	26,592	▲844
無形固定資産	904	1,160	255
投資その他の資産	13,891	14,489	598
<b>資産合計</b>	130,787	<b>130,278</b>	<b>▲509</b>

負債	2023年度	2024年度	増減
<b>流動負債</b>	49,864	<b>43,295</b>	<b>▲6,569</b>
<b>固定負債</b>	15,621	<b>18,143</b>	<b>2,522</b>
<b>負債合計</b>	65,485	<b>61,439</b>	<b>▲4,046</b>

純資産	2023年度	2024年度	増減
<b>純資産合計</b>	65,302	<b>68,839</b>	<b>3,536</b>

## 主な増減要因

- 流動資産：売上債権の回収（入金）が進み現金及び預金が増加
- 流動負債：短期借入金の返済が進み減少  
生産が進捗したことにより契約負債が減少
- 固定負債：大型案件や長納期案件増により長期借入金が増加

## Ⅱ. 2025年度 通期業績予想（連結）

## 通期業績予想

- 2025年度（2026年3月期）は売上高 960億円、営業利益 84億円の増収増益見通し

（単位：百万円）

	2024年度	2025年度	対前期	
	実績	通期予想	増減額	増減率
売上高	88,483	96,000	7,516	8.5%
自動車関連	43,059	43,000	▲59	▲0.1%
半導体関連	30,186	36,000	5,813	19.3%
その他自動省力機器	13,096	15,000	1,903	14.5%
その他	2,141	2,000	▲141	▲6.6%
営業利益（率）	6,898（7.8%）	8,400（8.8%）	1,501	21.8%
経常利益（率）	6,889（7.8%）	8,200（8.5%）	1,310	19.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益（率）	4,778（5.4%）	5,700（5.9%）	921	19.3%

## 通期業績予想のポイント：売上高

- 2025年度売上高予想は対前期8.5%増の960億円（過去最高）
- 半導体関連を中心に増収を見込む

### ① 自動車関連 430億円（対前期▲0億円）

- ・内燃機関、EV向けバッテリーを中心に底堅い需要の継続を見込む
- ・当社における基盤事業として、生産性の向上と適切な価格転嫁を図る

### ② 半導体関連 360億円（対前期+58億円）

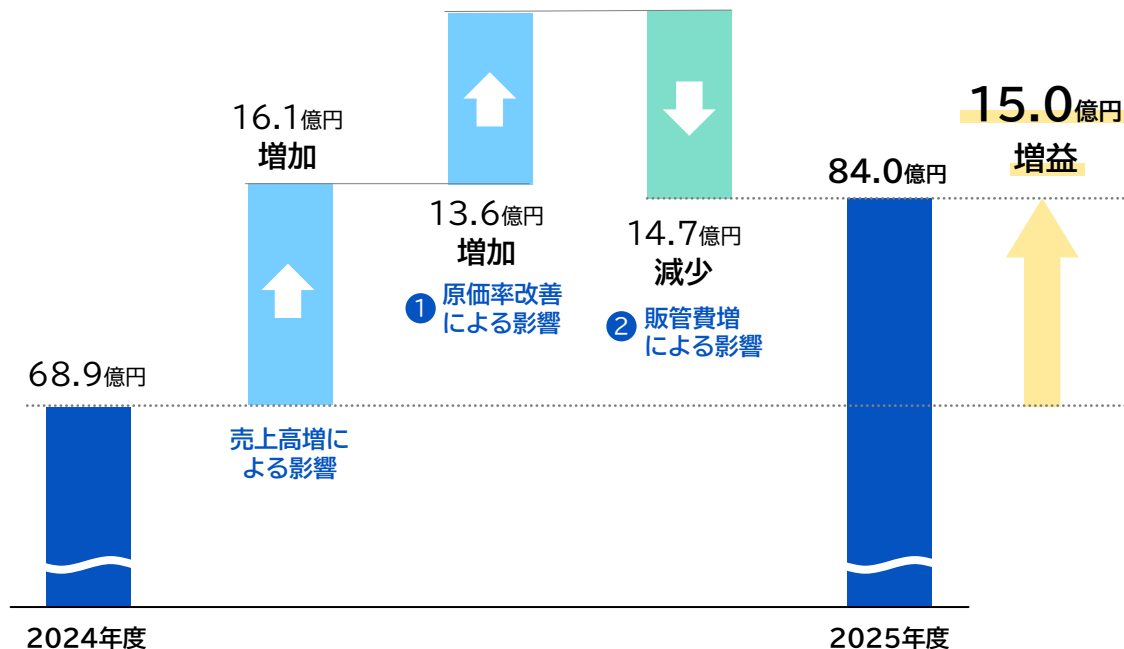
- ・2025年度も生成AI関連の半導体需要に期待
- ・新商品の開発や供給能力の増強により、市場ニーズに対応するとともにシェアアップを図る

### ③ その他自動省力機器 150億円（対前期+19億円）

- ・過去の経験を活かし、収益性の高い引合等への対応に集中

## 通期業績予想のポイント：営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前期で15.0億円増
  - 主な増加要因：売上高の増加、原価率の改善
  - 主な減少要因：販管費の増加



### ① 原価率改善による影響

原価率 78.6% ⇒ 77.2%

原価率改善の主な要因

- ・ 価格転嫁の推進
- ・ 習熟度向上による収益性の改善 等

### ② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- ・ 研究開発費増
- ・ 賃上げ・人員増による人件費増
- ・ システム関連費用増 等

## Ⅲ. 株主還元等について



## 1株当たり配当金・配当性向 推移および予想

(単位：円)

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 予想
1株当たり配当金	65.00	65.00	90.00	100.00	120.00	65.00
連結配当性向(%)	16.6	25.2	21.9	23.9	25.9	35.3

株式分割 (3分割)

## &lt;配当に対する考え方&gt;

2024年度の配当につきましては、2025年5月9日開催の取締役会において、1株当たり120円とすることを決議いたしました。

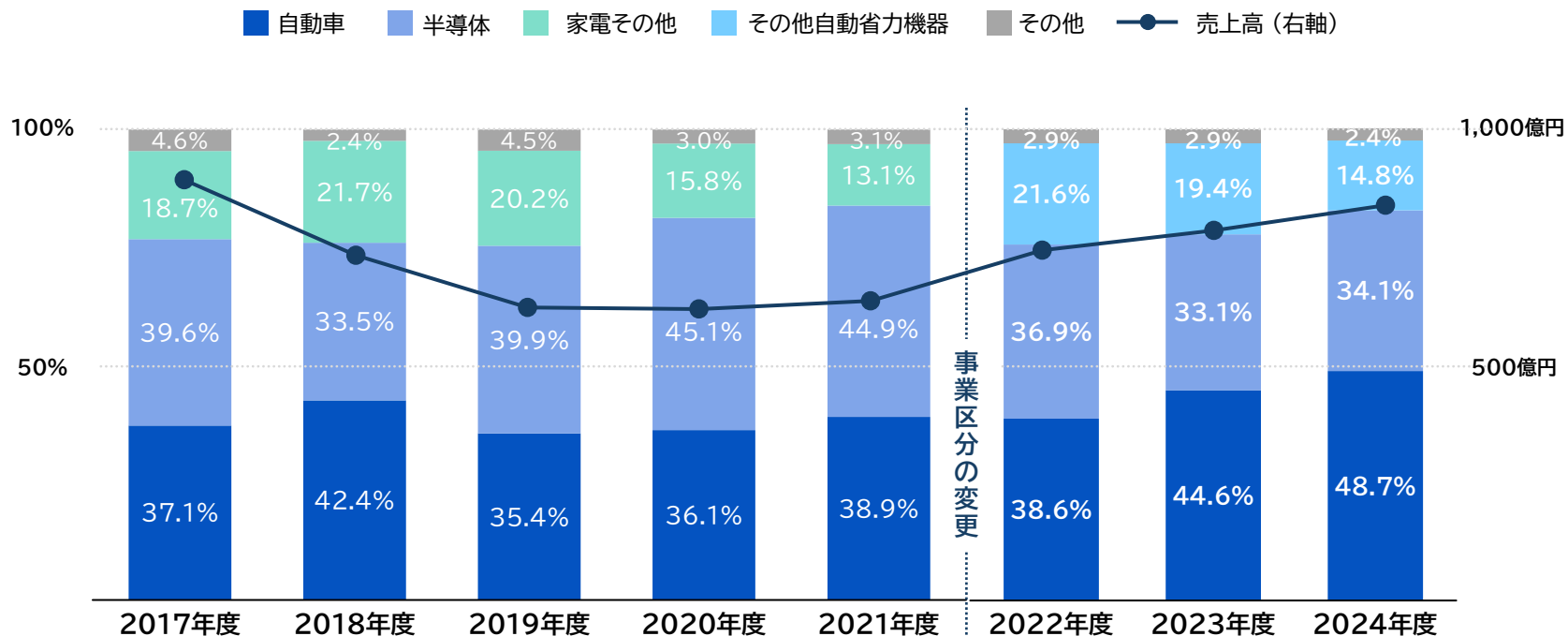
2025年度以降の配当につきましては、中期経営計画（2025-2027年度）で定める企業価値向上に向けた成長戦略に基づき、キャッシュ・アロケーション方針における成長投資と株主還元の配分を定め、連結配当性向の目安を20%から35%の水準に引き上げることといたしました。

2025年度につきましては、期末配当として1株当たり65円を予想しております。

※ 2025年3月31日を基準日、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております

## IV. 参考資料

## セグメント別 売上高・構成比推移

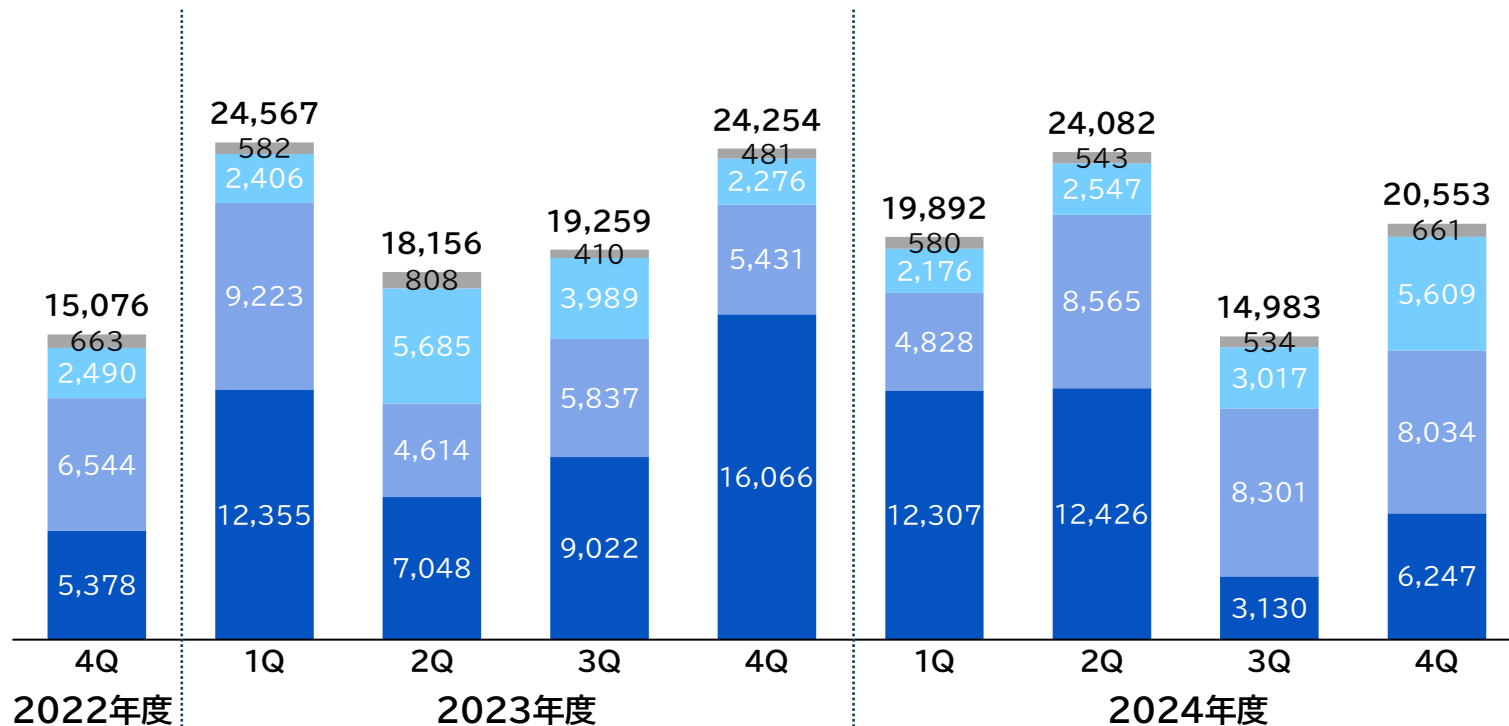


※2022年度より、事業区分の変更を行っております。

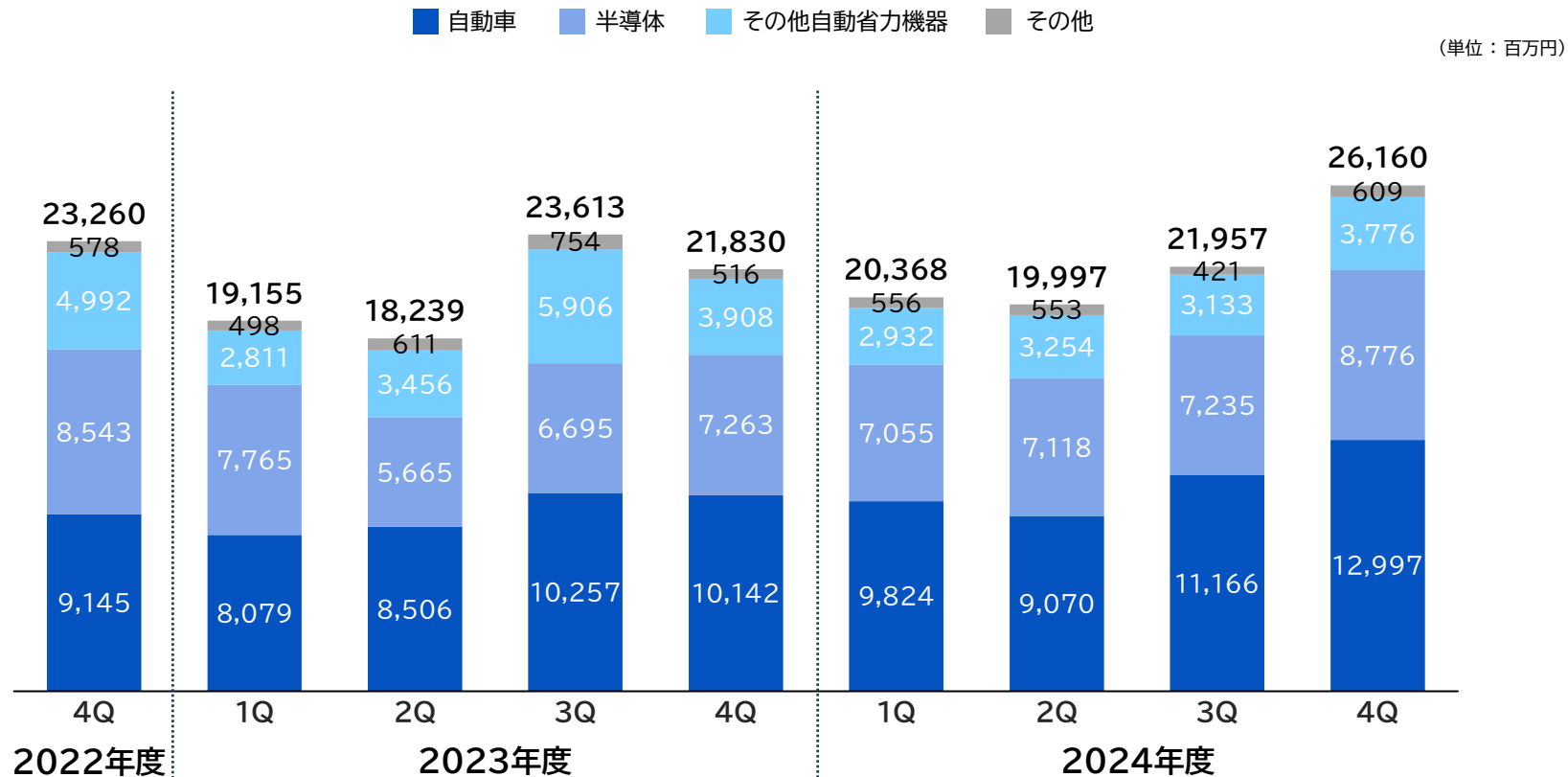
## セグメント別 四半期推移【受注高】

■ 自動車 ■ 半導体 ■ その他自動車省力機器 ■ その他

(単位：百万円)

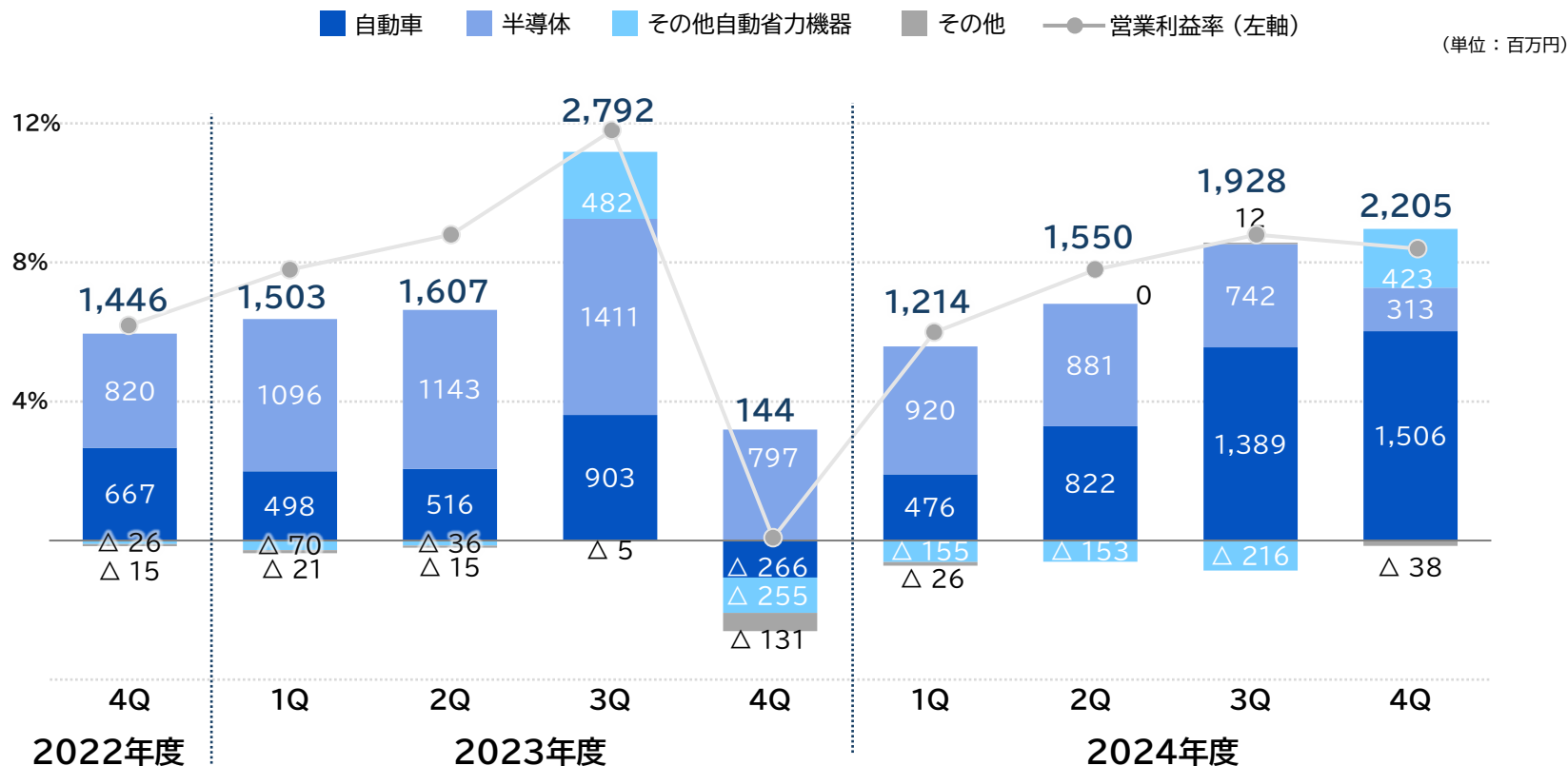


## セグメント別 四半期推移【売上高】

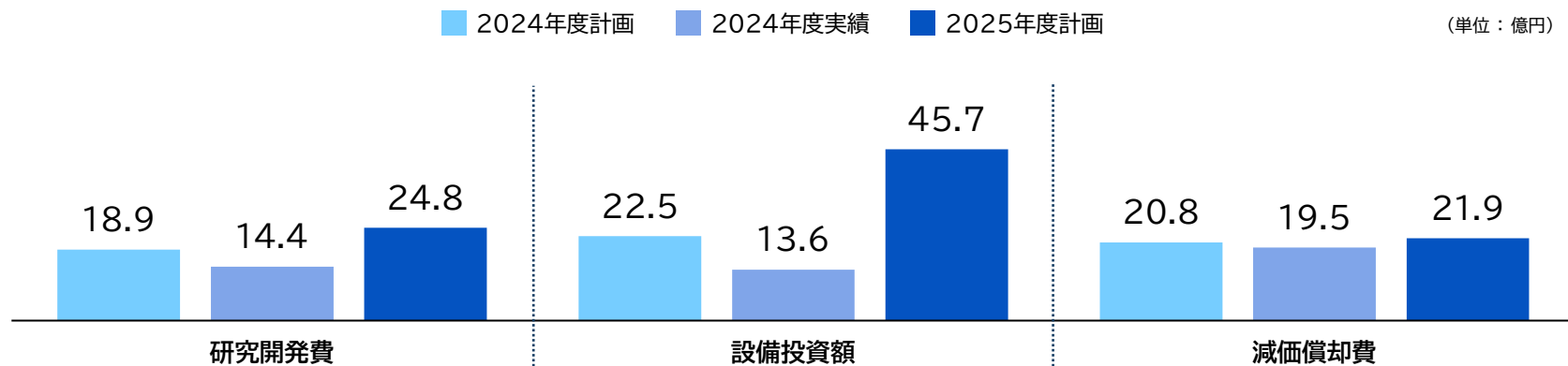


# セグメント別 四半期推移【営業利益】

※その他に消去含む



# 研究開発費・設備投資額・減価償却費

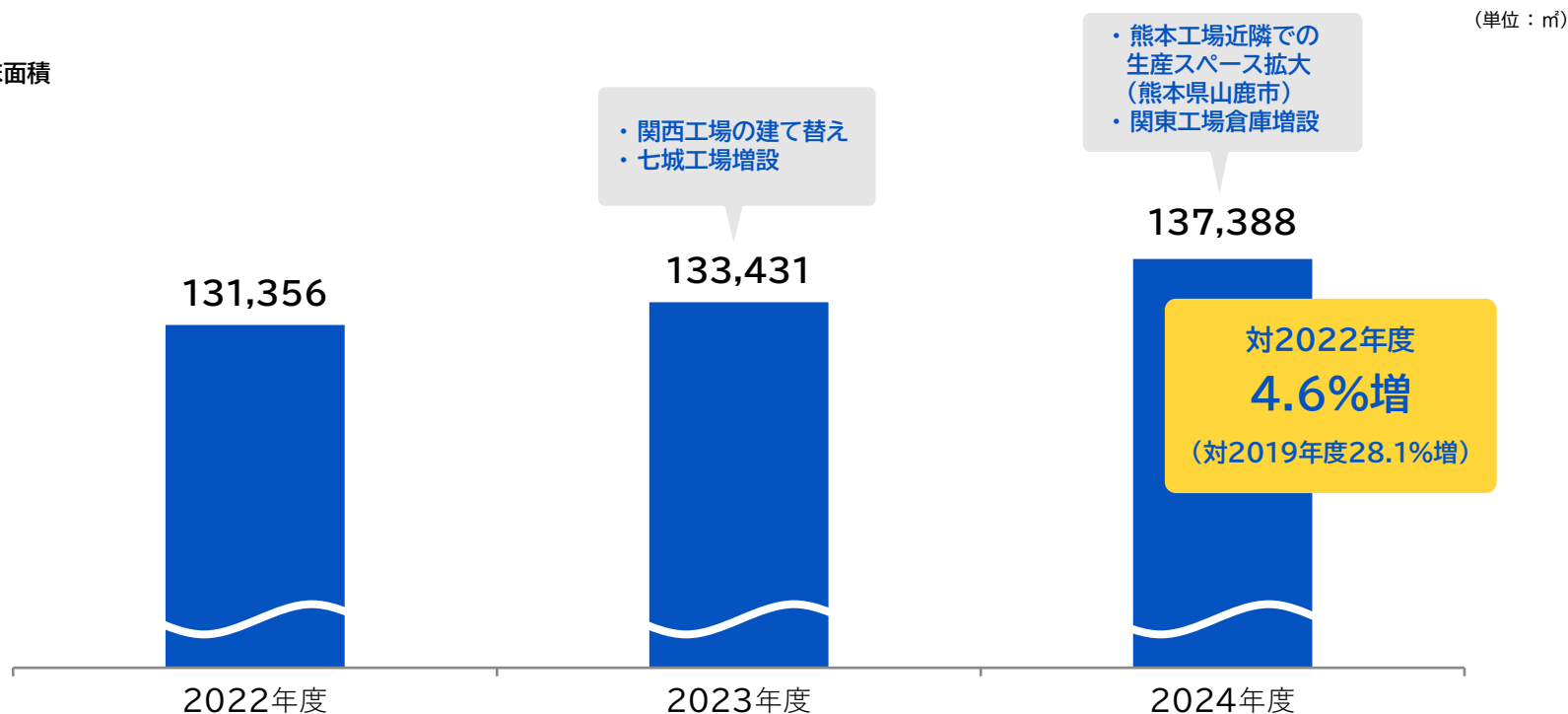


	2024年度 実績	2025年度 計画	増減理由
研究開発費	14.4 億円	24.8 億円	・ 量産製品の開発を推進
設備投資額	13.6 億円	45.7 億円	・ 生産・開発能力を増強
減価償却費	19.5 億円	21.9 億円	—

## 生産スペース(単体・期末時点)

- 生産能力向上に向けた生産スペースの継続的な拡大に取り組んでいる
- 2024年度は熊本市に隣接する山鹿市に生産スペースを確保

■ 延床面積

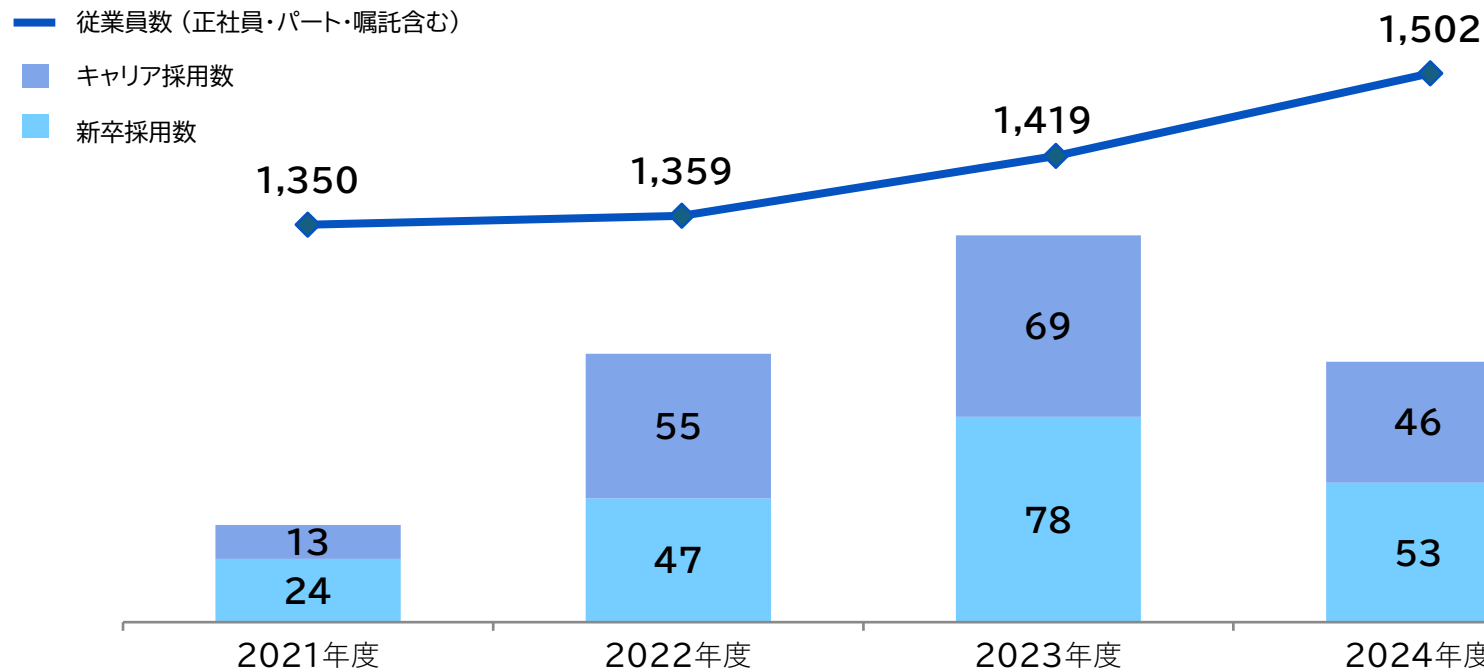




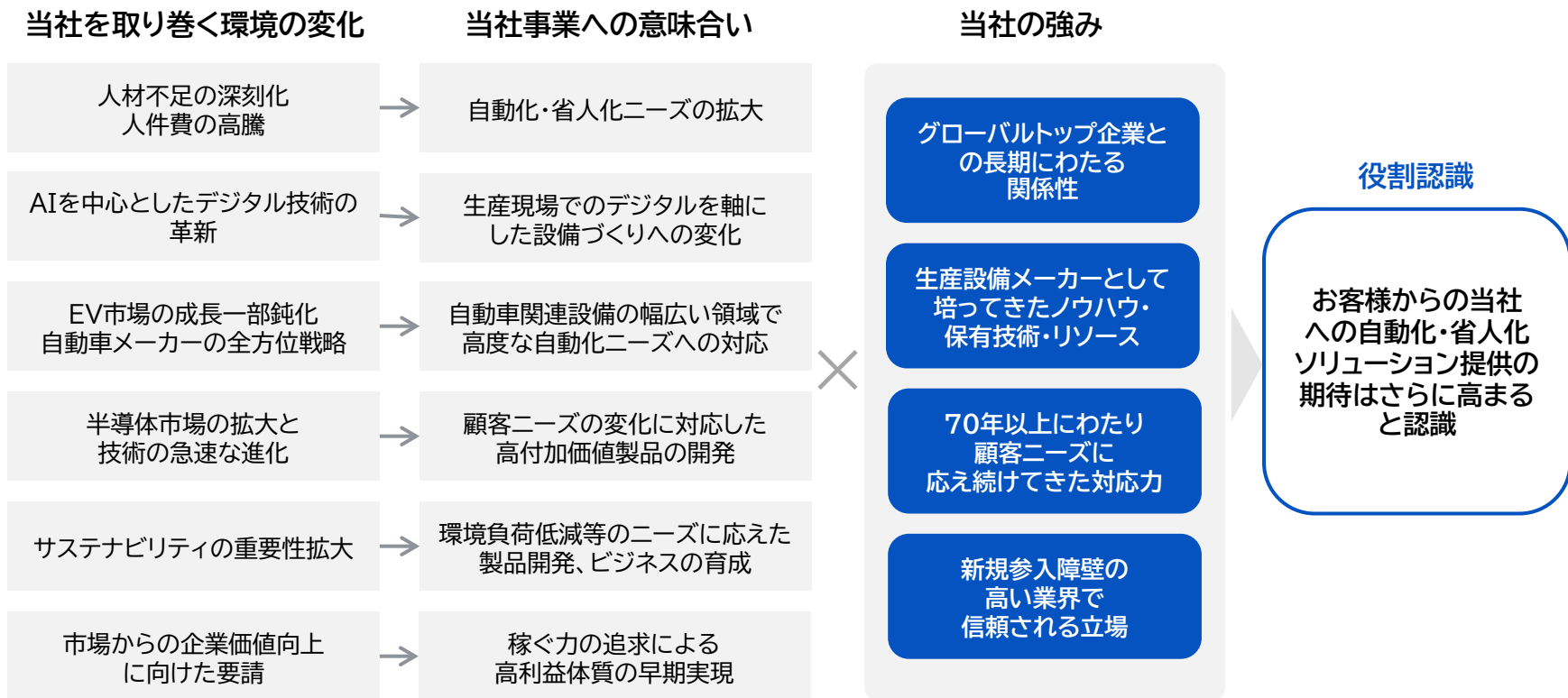
## 採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む

(単位：人)



# 外部環境と成長機会







## 開示情報：大型案件の受注

### 2023年度以降に開示した大型受注案件

事業部門	開示日		設備概要	金額
自動車関連	2023年	6月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	80億円超
	2024年	1月	EV向けバッテリー充放電関連設備	40億円超
		2月	内燃機関向けエンジン組立設備	約130億円
		5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約25億円
		8月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約56億円
		8月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	約87億円

- ・バッテリー充放電関連設備は2022年度より本格的な受注を開始し、受注実績は累計で150億円超
- ・大規模案件への対応力ならびにこれまでの納入実績等が評価され、継続して受注獲得

## ESG経営の取り組み強化

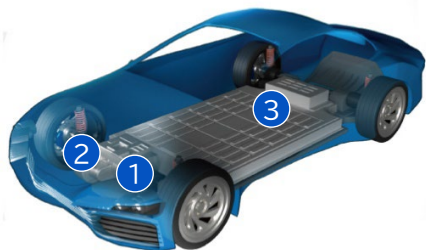
2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足 HPに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化	 <p>WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT</p>
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名	
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入	
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明	
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定 サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置	 <p>FTSE Blossom Japan Index</p>  <p>FTSE Blossom Japan Sector Relative Index</p>
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定	
	11月	「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」への参画	
2025年	3月	EcoVadis サステナビリティ評価「シルバーメダル」獲得	 <p>SILVER   Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2025</p>

## 事業概要：自動車関連の主要製品

- EV関連を中心に、北米自動車メーカー（ビッグスリー）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注

### EV関連の主力・拡大分野

#### 当社が手掛ける生産設備



※完成製品イメージ

### 主要な地域・顧客・優位性

#### EDU組立設備

北米

- 顧客
- ・北米自動車メーカー（ビッグスリー）
  - ・北米新興EVメーカー

#### IGBT・インバーター組立設備

日本

- 顧客
- 国内車載用電子部品メーカー

#### バッテリー関連組立設備（充放電工程）

日本

- 顧客
- 国内バッテリーメーカー

#### 当社の競争優位性

- ・最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- ・顧客の生産ラインを一度自社工場内で構築し、生産能力・品質を検証した上で現地据え付け
- ・開発から生産・保守までの一貫体制
- ・顧客要求に応えるエンジニアリング力

#### ① EDU組立設備 主力分野

EDU (Electric Drive Unit) と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造



#### ② IGBT・インバーター組立設備 主力分野

IGBTやインバーターといった、EVやトランスミッション車に搭載される車載用電子部品の組立設備を製造



#### ③ バッテリー関連組立設備（セル充放電工程） 拡大分野

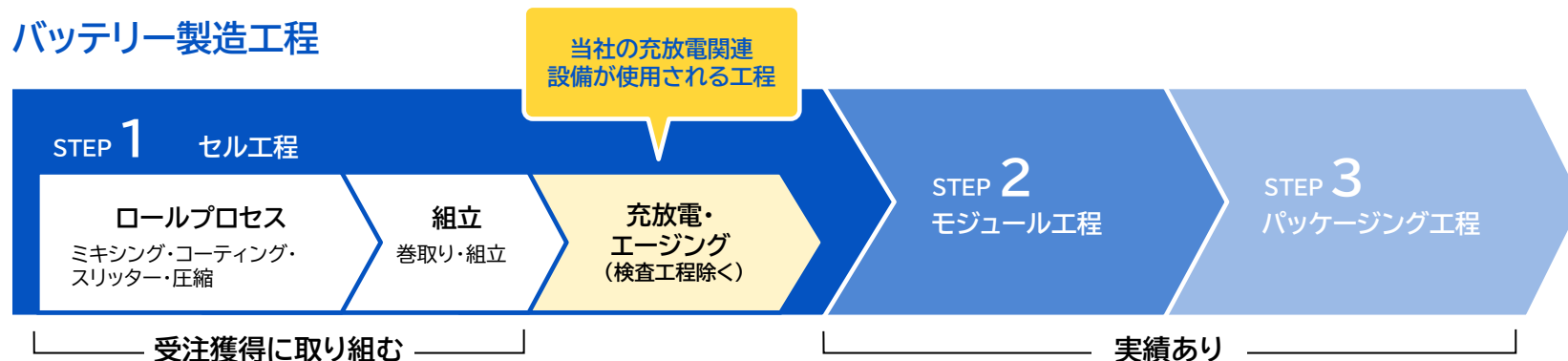
バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造



## 事業概要：充放電関連設備

- セル製造の最終工程である「充放電・エージング」を担う充放電関連設備
- 搬送・ストッカー技術を生かしたシステム化に当社優位性あり

### バッテリー製造工程



### 当社の製品：充放電関連設備

- 組み立てられたセル（電池）に充放電を繰り返すことでセルを活性化させる（バッテリーとしての機能をもたせる）工程
- 当社で製造した搬送ラインや自動倉庫に、外部より調達した充放電機を組み込み、システムとして顧客に納品  
当社の搬送・ストッカー技術が差別化要因

#### 搬送システム

工程間の最適搬送を行う

#### エージング用 倉庫システム

高温環境でのテストや自動倉庫に長期間収納放置し、一定期間後のセル電圧をパフォーマンス測定

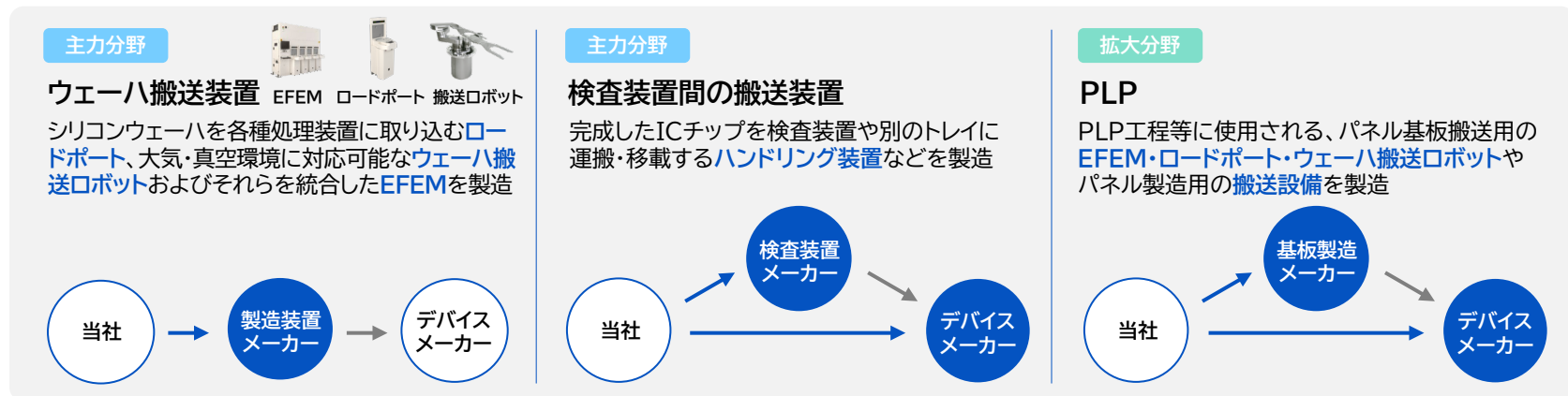
#### 充放電用 倉庫システム

満充電と放電を数回繰り返す工程。充電容量、充電速度、繰り返し回数等によって数時間を要する

## 事業概要：半導体関連の主要製品

- 国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注

### 半導体関連の主力・拡大分野



### 主要な地域・顧客・優位性

ウェーハ搬送装置	検査装置間の搬送装置	PLP
日本	北米・日本	北米・欧州・日本
顧客 国内製造装置メーカー	顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内検査装置メーカー	顧客 ・北米デバイスメーカー ・国内/欧州基板製造メーカー

#### 当社の競争優位性

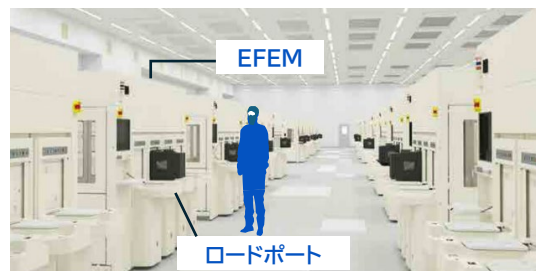
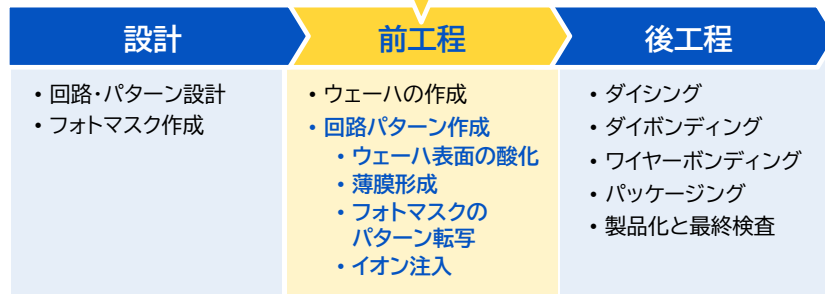
- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見・技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

# 事業概要：ウェーハ搬送装置

- 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、ウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEM（イーフェム）を設計・製造

## 半導体製造工程

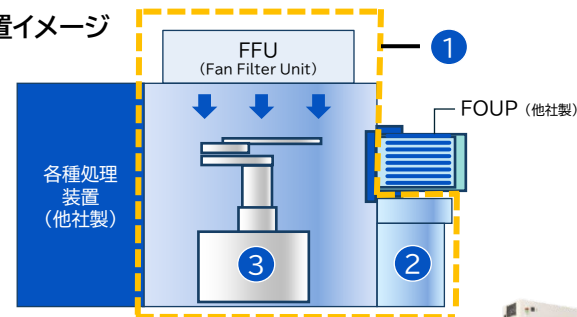
当社ウェーハ搬送装置が主に使用される工程



- 各種処理装置ごとにEFEM・ロードポートが設置される
- 1つのラインで複数のEFEM・ロードポートが用いられる

## 当社の主要製品

当社製品設置イメージ



- EFEM (Equipment Front End Module)**  
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前面にロードポートが設置される
- ロードポート**  
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている
- ウェーハ搬送ロボット**  
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器

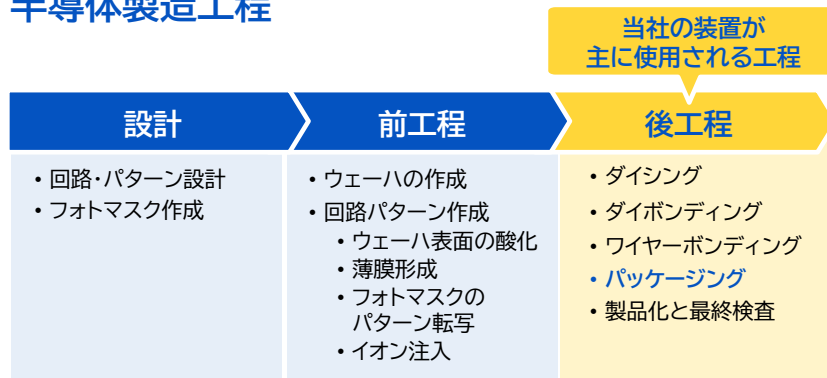




# 事業概要：PLP

- 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

## 半導体製造工程



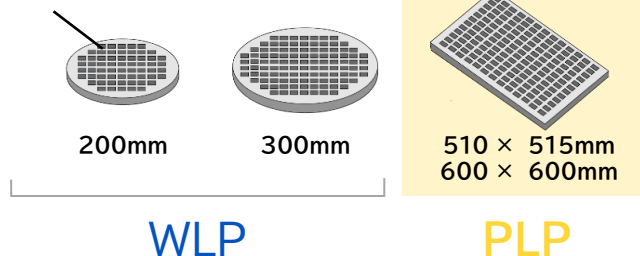
## PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板上に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的に510×515mm角など、ウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用

## パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
<b>WLP</b> (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 <b>良品チップのみをウェーハに再配列</b> し、チップがウェーハ上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
<b>PLP</b> (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、 <b>良品チップのみを四角形のパネルに再配列</b> し、チップがパネル上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける

再配列されたチップ



## 事業概要：その他自動省力機器

- 有機ELの蒸着装置や家電メーカー向けの組立設備、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

### その他自動省力機器の主力・新規分野

#### 主力分野

##### 医療理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

#### 主力分野

##### 家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモーターの組立設備をはじめあらゆる設備・装置を製造

##### 有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

#### 収益化に向けた新規分野

##### 超音波ガイド下 集束超音波治療装置

- すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス株式会社（本社：東京都新宿区、以下「ソニア社」）と共同開発中
- ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- 臨床試験がスタートし、次なる量産用装置の開発に着手した

### 主要な地域・顧客・優位性

#### 医療・理化学機器

日本

顧客 国内医療専門メーカー

#### 家電メーカー向け 組立設備

アジア

顧客 アジア家電製造メーカー

#### 有機EL用蒸着装置

日本

顧客 国内製造装置メーカー

#### 当社の競争優位性

- さまざまな分野の生産設備・装置に携わってきた豊富な知見とノウハウ
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

# 事業概要：超音波ガイド下集束超音波治療装置

- 医療・理化学機器分野での検体検査自動化の経験とロボット技術を応用し「治療」領域へ進出

## 当社既存事業 平田機工バイオ機器部

### 「検体検査」の自動化技術



医療機器20年以上の実績  
(クラス I：一般医療機器)

## 新規パートナー ソニア社

### 臨床・治験・集束超音波技術

東京女子医科大学、東北大学、東京医科大学  
で10年以上掛けて築き上げてきた技術

## 当社既存技術 平田機工ロボット事業部

### ロボット技術

産業用ロボットの実績



## 新分野への進出

ソニア社にて治験を実施  
当社は製造体制を構築

### がん治療装置 共同開発

販売開始・量産を目指す  
(クラス III：高度管理医療機器)

- 医療・理化学機器分野において、ソニア社と提携
- 治験(臨床試験)用のがん治療装置の共同開発を実施(切除不能のすい臓がんが対象)
- 皮膚切開や臓器の切除を伴わない低侵襲な治療のための装置を開発
- 複数の国内病院に納入し、ソニア社にて国内治験を実施中。当社は納入後のアフターサービスを実施中
- 今後は装置の安全性、ユーザビリティ(使用性)、デザインなどをブラッシュアップし、量産装置の開発、量産体制の構築を目指す
- 海外展開を計画しており、海外病院への早期納入および当社海外拠点でのアフターサービスを目指す

## 本資料のお取り扱い上のご注意

---

### ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。